

Bitte
Ausreichend
frankieren

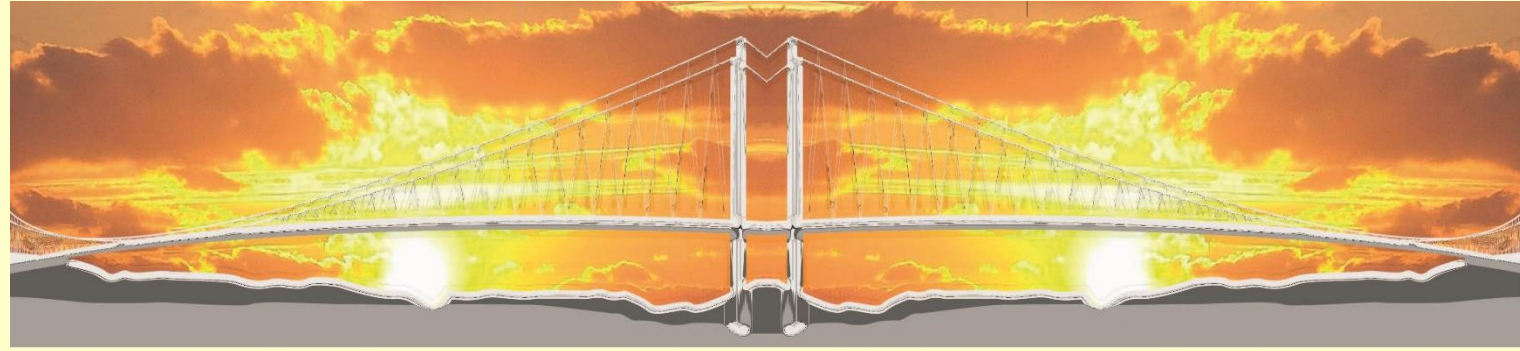
DGEB

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Lehrstuhl für Geomechanik und Geotechnik

Ludwig-Meyn-Straße 10

24118 Kiel



Kontakt

Deutsche Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und
Baudynamik e.V.

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Lehrstuhl für Geomechanik und Geotechnik

Ludwig-Meyn-Straße 10

D-24118 Kiel

Telefon: + 49 | 431 | 880 2840

Telefax: + 49 | 431 | 880 7606

Email: kontakt@dgeb.org

Internet: www.dgeb.eu

Vorstandsmitglieder

Prof. Dr.-Ing. habil. Frank Wuttke
frank.wuttke@ifg.uni-kiel.de

Prof. Dr. Thomas Spies
thomas.spies@bgr.de

Prof. Dr. Fabrice Cotton
fabrice.cotton@gfz-potsdam.de

Univ.Prof.Dr.-Ing. Hamid Sadegh-Azar
hamid.sadegh-azar@bauing.uni-kl.de

Dr.-Ing. Mathias Raschke
Mathias.raschke@ecclesia.de

Dr.-Ing. Phillipe Renault
renault@sda-engineering.de

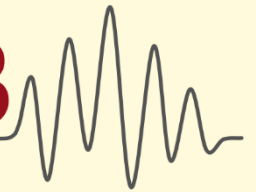
Dipl.-Ing. Pierre Wörndle
pierre.woerndle@hochtief.de

Struktur und Kompetenz

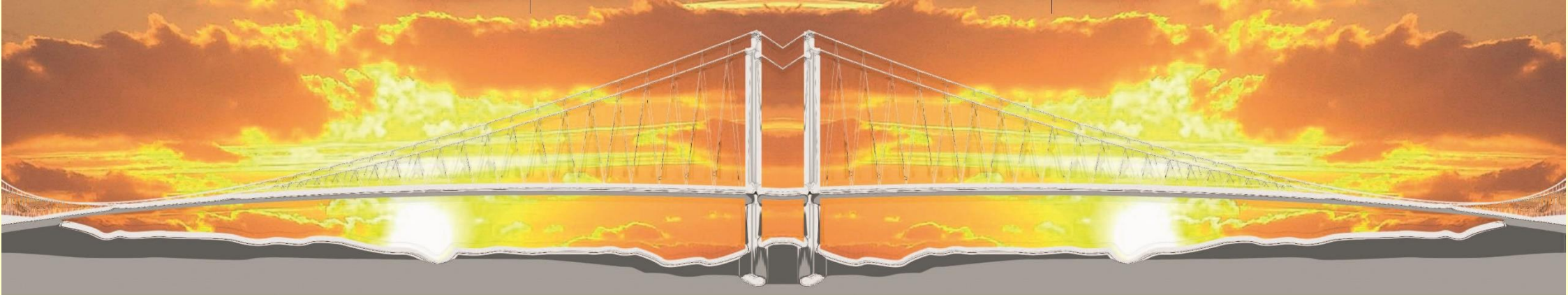
Zielsetzung

Aktivitäten

DGEB



Deutsche Gesellschaft für Erdbeben-
ingenieurwesen und Baudynamik e.V.



Struktur und Kompetenz

Die Deutsche Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik e.V. (DGEB) ist eine wissenschaftlich-technische Vereinigung, die Ingenieure, Geowissenschaftler und Seismologen interdisziplinär vereint.

Derzeit zählt die DGEB rund 270 Mitglieder – darunter 20 aus dem benachbarten Ausland – sowie über 30 Fördermitglieder. Sie wird von einem siebenköpfigen Vorstand mit Vertretern aus den oben genannten Bereichen geleitet.

Zielsetzung

Die DGEB hat sich zum Ziel gesetzt, die Kontakte und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren, Seismologen und Geowissenschaftlern sowie zwischen den Vertretern aus Forschung, Behörden und Wirtschaft auf den Gebieten des Erdbebeningenieurwesens und der Baudynamik zu fördern.

Insbesondere soll die enge fachliche Verbindung zwischen dem Erdbebeningenieurwesen und der Baudynamik weiterentwickelt werden.

Die DGEB ist vertreten in den folgenden internationalen Vereinigungen

International Association of Earthquake Engineering (IAEE)

European Association of Earthquake Engineering (EAEE)

Earthquake Engineering Research Institute (EERI)

Aktivitäten

Schaffung eines Netzwerks von Experten für Problemstellungen im Bereich des Erdbebeningenieurwesens und der Baudynamik.

Mitwirkung in Gremien zur Normung und Standardisierung.

Mitwirkung in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion bei Fragen der Tragwerksdynamik und des Erdbebeningenieurwesens.

Nachwuchsförderung – Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im Erdbebeningenieurwesen und der Baudynamik durch Vergabe von Förderpreisen für Studienabschlussarbeiten und Dissertationen.

Fachtagungen – Die DGEB führt zusammen mit den Gesellschaften für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik aus Österreich (OGE) und der Schweiz (SGEB) im zweijährigen Rhythmus D-A-CH-Tagungen durch.

Publikationen – Mitteilungsblatt für die Mitglieder in der Zeitschrift der „Bauingenieur“, gemeinsam mit der OGE und der SGEB, DGEB-Publikationen (bisher erschienen: 18 Bände), Konferenzbände der DGEB- Fachtagungen.

Erdbebenerkundungen – DGEB Task-Force Einsätze für Erdbebenerkundungsmissionen.

Werden Sie Mitglied ...

Um diese Aktivitäten erfolgreich wahrnehmen zu können, benötigen wir engagierte und kompetente Mitglieder in unserer Gesellschaft. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden. Informieren Sie sich auf unserer Internetseite www.dgeb.eu über die Vorzüge, in der DGEB Mitglied zu sein

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt zur Deutschen Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamik (DGEB) e. V.:

Name:

Vorname:

Straße:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Ich habe die Satzung zur Kenntnis genommen und bin bereit, den Beitrag von jährlich:

- € 35,00 als ordentliches Mitglied
- € 10,00 als studentisches Mitglied
- € 120,00 als förderndes Mitglied ohne Gewinn
- € 300,00 als förderndes Mitglied mit Gewinn

zu zahlen (Stand 2021):

Bankdaten: Postbank Hannover

IBAN: DE25 2501 0030 0064 5803 07

BIC: PBNKDEFFXXX

Ort / Datum:

Unterschrift: